

Laudo Técnico

SMT HTT 2.0

1 Modelo

SMT HTT 2.0

2 Marca

SMT maschinen und vertriebs gmbh & co kg

3 Descrição Técnica do Bem

- Forno de pré-aquecimento e secagem para aplicação de underfill em placas eletrônicas denominadas PCB's;
- Sistema de transporte Interno;
- Para o pré aquecimento e secagem de aplicações sensíveis em semicondutores até uma linha completa de revestimento isolante com dispensador integrado para uma aplicação precisa e secagem de aplicações de underfill e verniz;
- Transferência de calor via convecção e radiação infravermelha
- Sistemas de transporte flexíveis internos;
- Atinge temperaturas de até 300°C para o pré aquecimento e secagem completa dos componentes;
- Secagem por convecção;
- Monitoramento interno de temperatura;
- Sistema de exaustão integrado;

4 Aplicação

Forno para pré aquecimento e secagem de PCBs que após isso sofrerão aplicação de underfill ou verniz, o aquecimento ocorre através de um sistema de convecção infravermelha por resistências internas localizadas no interior da máquina e um computador que realizará o cálculo dos algoritmos para manter a temperatura do forno estável e dentro dos limites necessários conforme requisitos principais do processo, as placas se movimentarão de uma ponta a outra do forno através de um sistema de transporte no interior da máquina, a máquina terá o controle total sendo realizado pelo monitor e pelo computador localizado na máquina.

5 Descrição dos Bens

Máquinas e periféricos

FOTOS	Descrição
1	Forno SMT para pré-aquecimento e secagem de PCBs (placas eletrônicas)

